

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人 三好 秀和 様 あて名 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番3号 虎ノ門第一ビル9階		RECEIVED 2004. 7. 14 MIYOSHI PATENT		Written Opinion of the ISA PCT 国際調査機関の見解書 （法施行規則第40条の2） （PCT規則43の2.1）	
出願人又は代理人 の書類記号 JHTK-65-PCT		発送日 （日.月.年） 13. 7. 2004			
国際出願番号 PCT/J P 2004/005004		国際出願日 （日.月.年） 07. 04. 2004		優先日 （日.月.年） 07. 04. 2003	
国際特許分類（IPC）IntCl ¹ C08L63/00					
出願人（氏名又は名称） 日立化成工業株式会社					

1. この見解書は次の内容を含む。 <input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 見解の基礎 <input type="checkbox"/> 第II欄 優先権 <input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 <input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如 <input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 <input checked="" type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献 <input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備 <input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見	
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。 この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。 さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。	
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。	

見解書を作成した日 22. 06. 2004	
名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 加賀 直人 電話番号 03-3581-1101 内線 3455
	4 J 9843

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された P C T 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	19-20	有
	請求の範囲	1-18, 21-35	無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-35	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-35	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1 : JP 2003-82243 A1 (日東電工株式会社)2003.03.19
 文献2 : JP 2001-151866 A1 (日立化成工業株式会社)2001.06.05
 文献3 : JP 10-101906 A1 (信越化学工業株式会社)1998.04.21
 文献4 : JP 10-158365 A1 (住友ベークライト株式会社)1998.06.16
 文献5 : JP 3-177450 A1 (日立化成工業株式会社)1991.08.01
 文献6 : JP 2001-131391 A1 (東レ株式会社)2001.05.15
 文献7 : JP 2002-322345 A1 (松下電工株式会社)2002.11.08
 文献8 : JP 2000-53844 A1 (東芝ケミカル株式会社)2000.02.22
 文献9 : JP 11-106480 A1 (住友ベークライト株式会社)1999.04.20
 文献10 : WO 02/24808 A1 (日立化成工業株式会社)2002.03.28
 文献11 : JP 2003-26769 A1 (日立化成工業株式会社)2003.01.29
 文献12 : JP 11-323090 A1 (日立化成工業株式会社)1999.11.26
 文献13 : JP 63-245947 A1 (日東電工株式会社)1988.10.13
 文献14 : JP 10-114853 A1 (株式会社日立製作所)1998.05.06
 文献15 : JP 2000-273287 A1 (信越化学工業株式会社)2000.10.03
 文献16 : JP 7-242731 A1 (住友ベークライト株式会社)1995.09.19
 文献17 : JP 7-122683 A1 (住友ベークライト株式会社)1995.05.12

特定の無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料に関し、
 請求の範囲1-13, 16, 21-22, 26-35については、文献1
 請求の範囲1-16, 21-35については、文献2
 請求の範囲1-7, 9-15, 21-27, 30-35については、文献3
 請求の範囲1-6, 9-13, 30-31については、文献4
 請求の範囲1-4, 9-13, 21-22, 26-27, 30-35については、文献5
 請求の範囲1, 9-13, 31については、文献6, 7
 請求の範囲1, 3-4, 9-13, 21-22, 26-27, 30-35については、文献8
 請求の範囲2, 9, 11, 13, 21-22, 31については、文献9
 請求の範囲3-9, 13-18, 21-35については、文献10
 請求の範囲4-9, 13, 21-22, 26-35については、文献11に記載された発明であり、
 新規性を有さない。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2004-59779 A 「EX」	26. 02. 2004	30. 07. 2002	
JP 2003-321594 A 「EX」	14. 11. 2003	26. 04. 2002	

2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求の範囲 14-18 について

国際調査報告で引用された文献 12 には、半導体封止用エポキシ樹脂組成物におけるパッケージの成形性向上等のためアミノシランカップリング剤を、難燃性向上のためリン酸エステル化合物を配合する旨の記載があることからすると、上記効果を得るため、この技術を文献 1-11 に記載の樹脂組成物に採用することで、請求の範囲 14-18 にかかる発明とすることは、当業者において、容易に想到しうることである。

請求の範囲 19-20 について

国際調査報告で引用された文献 13、14 には、半導体封止用エポキシ樹脂組成物における難燃性向上のためホスフィンオキサイドを配合する旨の記載があることからすると、上記効果を得るため、この技術を文献 1-11 に記載の樹脂組成物に採用することで、請求の範囲 19-20 にかかる発明とすることは、当業者において、容易に想到しうることである。

請求の範囲 23-25 について

国際調査報告で引用された文献 15-17 に記載のとおり、半導体封止用エポキシ樹脂組成物において、シランカップリング剤が揮発成分となりボイド等を生じるためその配合量を規定することは周知の技術であり、この周知技術を文献 1-11 に記載の樹脂組成物に付加することで、請求の範囲 23-25 にかかる発明とすることは、当業者において、容易に想到しうることである。